DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

16327696

Basic Patent (No, Kind, Date): WO 200060906 A1 20001012 <No. of Patents: 004>

ORGANIC EL DEVICE (English)
Patent Assignee: TDK CORP (JP)

Author (Inventor): ARAI MICHIO; MITSUHASHI ETSUO; KOBORI ISAMU (Regional)

AT; BE; CH; CY; DE; DK; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; LU; MC; NL; PT; SE

Filing Details: WO 100000 With international search report

IPC: \*H05B-033/22; H05B-033/14

CA Abstract No: \*133(20)288616R; 133(20)288616R Derwent WPI Acc No: \*C 00-638524; C 00-638524

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

 EP 1093323
 A1
 20010418
 EP 99926813
 A
 19990625

 JP 2000294375
 A2
 20001020
 JP 9997842
 A
 19990405

 US 6252246
 BA
 20010626
 US 339804
 A
 19990625

WO 200060906 A1 20001012 WO 99JP3395 A 19990625 (BASIC)

Priority Data (No, Kind, Date):

WO 99JP3395 W 19990625

JP 9997842 A 19990405

DIALOG(R)File 347: JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

06708543 \*\* Image available \*\*

ORGANIC EL ELEMENT

PUB. NO.: 2000-294375 [JP 2000294375 A]

PUBLISHED: October 20, 2000 (20001020)

INVENTOR(s): ARAI MICHIO

MIHASHI ETSUO

KOBORI ISAMU

APPLICANT(s): TDK CORP

APPL. NO.: 11-097842 [JP 9997842] FILED: April 05, 1999 (19990405)

INTL CLASS: H05B-033/22; H05B-033/14

### ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic element of high efficiency and long life by comprising an organic layer having a luminescent layer between a hole injection electrode and an electron injection electrode, an inorganic insulating electron transporting layer between the luminescent layer and the electron injection electrode, a hole injection transporting layer between the luminescent layer and the hole injection electrode, and an organic electron injection layer between an inorganic insulating electron transporting layer and the electron injection electrode. SOLUTION: An organic EL element is formed by successively laminating a substrate 1, a hole injection electrode 2, a hole injection transporting layer 3, a luminescent layer 4, an inorganic electron transporting layer of high resistance 5, an electron injection layer 6, and an electron injection electrode 7, and connecting a driving power source E between the hole injection electrode 2 and the electron injection electrode 7 for adjustment of color tone of the luminescent color, and multicolorization. By mounting the inorganic hole injection transporting layer, the heat resistance and the weather resistance can be improved, and the life of the element can be elongated. By using the inexpensive and easily available inorganci material, the EL element can be easily manufactured with the low cost. The connetability with an electrode can be also improved, and the generation of leaked current and dark spot can be prevented.

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開2000-294375

(P2000-294375A):

(43) 公開日 平成12年10月20日(2000.10.20)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup> 識別記号	FI		テーマコード (参考)
	H05B 33/22	-A 3K0	
H05B 33/22	UADD 99/77	A JINO	
		, <b>L</b>	
33/14	33/14	The Artist	

審査請求 未請求 請求項の数13 〇L (全13頁)

(21)出願番号 特願

特願平11-97842

(22)出顧日

平成11年4月5日(1999.4.5)

(71)出願人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72) 発明者 荒井 三千男

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(72) 発明者 三橋 悦央

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 テイ

ーディーケイ株式会社内

(74)代理人 100082865

弁理士 石井 陽一

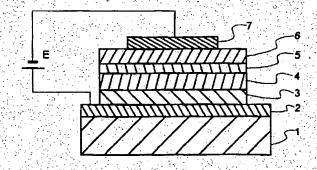
最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】有機EL素子

#### (57)【要約】

【課題】有機材料と無機材料の有するメリットを併せ持ち、高効率、長寿命で低コストな有機EL素子を提供する

【解決手段】 ホール注入電極と電子注入電極と、これらの電極間に少なくとも発光層を有する有機層とを有し、前記発光層と電子注入電極との間には無機絶縁性電子輸送層を有し、前記発光層とホール注入電極との間にはホール注入輸送層を有し、この無機絶縁性電子輸送層と電子注入電極との間には有機の電子注入層を有する有機EL素子とした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ホール注入電極と電子注入電極と、これらの電極間に少なくとも発光層を有する有機層とを有り

前記発光層と電子注入電極との間には無機絶縁性電子輸送層を有し

前記発光層とホール注入電極との間にはホール注入輸送層を有し、

この無機絶縁性電子輸送層と電子注入電極との間には有機の電子注入層を有する有機EL素子。

【請求項2】 前記無機絶縁性電子輸送層は、主成分として酸化ストロンチウム、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化リチウム、酸化ルビジウム、酸化カリウム、酸化ナトリウム、および酸化セシウムから選択される1種または2種以上の酸化物を含有する請求項1~7のいずれかの有機EL素子。

【請求項3】 前記無機絶縁性電子輸送層は、各構成成分が全成分に対して、

主成分:80~99 mol%,

安定剤: 1~20 mol%

含有する請求項1または2の有機EL素子。

【請求項4】 前記無機絶縁性電子輸送層の膜厚は、 0.1~2mである請求項1~3のいずれかの有機EL 素子。

【請求項5】 前記ホール注入輸送層は、電子をブロックするとともにホールを搬送するための導通パスを有する高抵抗の無機ホール注入輸送層である請求項1~4のいずれかの有機EL素子。

《請求項6】 前記高抵抗の無機ホール注入輸送層は、ホール輸送層、電子導電性を示しかつ強い発光を示すた 抵抗率が1~1×10<sup>11</sup>Ω・cmである請求項5の有機E 30 とえばAlq3 材からなる有機発光層を積層し、さら L素子。 に、MgAgなどの仕事関数の小さい電極を形成し、基

【請求項7】 前記高抵抗の無機ホール注入輸送層は、 金属および/または金属の酸化物、炭化物、窒化物、ケ イ化物および硼化物のいずれか1種以上を含有する請求 項5または6の有機EL素子。

【請求項8】 前記高抵抗の無機ホール注入輸送層は、シリコンおよび/またはゲルマニウムの酸化物を主成分とし、この主成分を( $Si_1$ ,  $Ge_1$ )O, と表したとき  $0 \le x \le 1$ 、

1.  $7 \le y \le 2$ . 2

であり、

さらに、仕事関数4.5eV以上の金属および/または金属の酸化物、炭化物、窒化物、ケイ化物および硼化物のいずれか1種以上を含有する請求項5~7のいずれかの有機EL素子。

【請求項9】 前記金属は、Au、Cu、Fe、Ni、Ru、Sn、Cr、Ir、Nb、Pt、W、Mo、Ta、PdおよびCoのいずれか〔種以上である請求項8の有機EL素子。

【請求項10】 前記金属および/または金属の酸化

物、炭化物、窒化物、ケイ化物および硼化物の含有量は、0.2~40 mol%である請求項8または9の有機EL素子。

【請求項11】 前記高抵抗の無機ホール注入輸送層の 膜厚は、0:2~100mである請求項5~10のいず れかの有機EL素子。

【請求項12】 前記ホール注入輸送層は無機絶縁性ホール注入輸送層であって、この無機絶縁性ホール注入輸送層は、シリコンおよび/またはゲルマニウムの酸化物 を主成分とし、

主成分の平均組成を、

(Si, Ge,) O,と表したとき

 $0 \le x \le 1$ 

1.  $7 \le y \le 1$ . 9 9

である請求項1~4のいずれかの有機EL素子。

【請求項13】 前記無機絶縁性ホール注入輸送層の膜厚は、0.1~3mmである請求項12の有機EL素子。 【発明の詳細な説明】

[0.001]

0. 【発明の属する技術分野】本発明は、有機EL(エレクトロルミネッセンス)素子に関し、詳しくは、有機化合物の薄膜に電界を印加して光を放出する素子に用いられる無機/有機接合構造に関する。

[0002]

【従来の技術】有機EL素子は、ガラス上に大面積で素子を形成できるため、ディスプレー用等に研究開発が進められている。一般に有機EL素子は、ガラス基板上にITO等の透明電極を形成し、その上に有機アミン系のホール輸送層、電子導電性を示しかつ強い発光を示すたとえばAlq3材からなる有機発光層を積層し、さらに、MgAgなどの仕事関数の小さい電極を形成し、基本素子としている。

[0003] これまでに報告されている素子構造としては、ホール注入電極及び電子注入電極の間に1層または複数層の有機化合物層が挟まれた構造となっており、有機化合物層としては、2層構造あるいは3層構造があ

【0.004】2層構造の例としては、ホール注入電極と電子注入電極の間にホール輸送層と発光層が形成された 40 構造または、ホール注入電極と電子注入電極の間に発光 層と電子輸送層が形成された構造がある。3層構造の例 としては、ホール注入電極と電子注入電極の間にホール 輸送層と発光層と電子輸送層とが形成された構造があ る。また、単一層に全ての役割を持たせた単層構造も高 分子や混合系で報告されている。

【0005】図2および図3に、有機EL素子の代表的な構造を示す。図2では基板11上に設けられたホール注入電極12と電子注入電極13の間に有機化合物であるホール輸送層14と発光層15が形成されている。この場合、発光層15は、電子輸送層の機能も果たしてい

る.

【0006】図3では、基板11上に設けられたホール 注入電極12と電子注入電極13の間に有機化合物であ るホール輸送層14と発光層15と電子輸送層16が形 成されている。

【0007】これら有機EL素子においては、共通し

て、信頼性が問題となっている。すなわち、有機EL素 子は、原理的にホール注入電極と、電子注入電極とを有 し、これら電極間から効率よくホール・電子を注入輸送 するための有機層を必要とする。しかしながら、これら 10 の材料は、製造時にダメージを受けやすく、電極との親 和性にも問題がある。また、有機薄膜の劣化もLED、 LDに較べると著しく大きいという問題を有している。 【0008】電界発光(EL)素子は、電界の影響によ り発光する。このようなELを構成する半導体層での作 用は、一対の電極から半導体に注入される電子ーホール 対の放射結合を通して行われる。その一例としては、G aPおよび同様なIII 族-V族半導体を基礎とする発光 ダイオードがある。これらの素子は、効果的且つ広範囲 に利用されているものの、その大きさが非常に微小であ 20 るために大面積ディスプレイに使用するに際しては、困 難を伴うばかりか不経済でもある。大面積ディスプレイ への使用が可能な代替品の材料は幾種類か知られてい る。そして、このような無機半導体のなかでもZnSが 最も有用である。しかしながら、この系は無視できない 実用上の欠点、第1に信頼性が乏しいという問題があ

【0009】このような問題を解決するために、有機材料と無機半導体材料のそれぞれのメリットを利用する方法が考えられている。すなわち、有機ホール輸送層を無機p型半導体に置き換えた有機/無機半導体接合である。このような検討は、特許第2636341号、特開平2-139893号公報、特開平2-207488号公報、特開平6-119973号公報で検討されているが、発光特性や基本素子の信頼性で従来素子の有機ELを越える特性を得ることが極めて困難であった。

る。ZnSに係るメカニズムの一例は、強電界下におい

て、半導体を通って1種のキャリヤが加速されることにより、放射発光によって緩和する半導体の局部的励起が

生じることであると考えられる。

#### [0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、有機 材料と無機材料の有するメリットを併せ持ち、高効率、 長寿命で低コストな有機EL素子を提供することであ る

#### [0011]

【課題を解決するための手段】すなわち、上記目的は、 以下の構成により達成される。

(1) ホール注入電極と電子注入電極と、これらの電 (11) 前記高抵抗の極間に少なくとも発光層を有する有機層とを有し、前記 は、0.2~100mmで発光層と電子注入電極との間には無機絶縁性電子輸送層 50 ずれかの有機EL素子。

を有し、前記発光層とホール注入電極との間にはホール 注入輸送層を有し、この無機絶縁性電子輸送層と電子注 入電極との間には有機の電子注入層を有する有機EL素 子。

- (2) 前記無機絶縁性電子輸送層は、主成分として酸化ストロンチウム、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化リチウム、酸化ルビジウム、酸化カリウム、酸化ナトリウム、および酸化セシウムから選択される1種または2種以上の酸化物を含有する上記(1)~(7)のいずれかの有機EL素子。
- (3) 前記無機絶縁性電子輸送層は、各構成成分が全成分に対して、

主成分:80~99 mol%.

安定剤: 1~20 mol%

含有する上記(1)または(2)の有機EL素子。

- (4) 前記無機絶縁性電子輸送層の膜厚は、0.1~ 2nmである上記(1)~(3)のいずれかの有機EL素
- (5) 前記ホール注入輸送層は、電子をブロックする とともにホールを搬送するための導通パスを有する高抵 抗の無機ホール注入輸送層である上記(1)~(4)の いずれかの有機EL素子。
- (6) 前記高抵抗の無機ホール注入輸送層は、抵抗率 が1~1×10<sup>11</sup>Ω·cmである上記(5)の有機EL素子。
- (7) 前記高抵抗の無機ホール注入輸送層は、金属および/または金属の酸化物、炭化物、窒化物、ケイ化物および硼化物のいずれか1種以上を含有する上記(5)または(6)の有機EL素子。
- 30 【0012】(8) 前記高抵抗の無機ホール注入輸送 層は、シリコンおよび/またはゲルマニウムの酸化物を 主成分とし、この主成分を(Si.,Ge.)O、と表し たとき

 $0 \le x \le 1$ .

1.  $7 \le y \le 2$ . 2

であり、さらに、仕事関数4.5eV以上の金属および/ または金属の酸化物、炭化物、窒化物、ケイ化物および 硼化物のいずれか1種以上を含有する上記(5)~

(7) のいずれかの有機EL素子。

- (9) 前記金属は、Au, Cu、Fe, Ni、Ru、Sn, Cr, Ir, Nb, Pt, W, Mo, Ta, Pd およびCoのいずれか1種以上である上記(8)の有機 EL素子。
- (10) 前記金属および/または金属の酸化物 炭化物、窒化物、ケイ化物および硼化物の含有量は、0 2~40 mol%である上記(8)または(9)の有機EL表子。
- (11) 前記高抵抗の無機ホール注入輸送層の股厚は、0.2~100mである上記(5)~(10) がれかの有機EL素子。

5

(12) 前記ホール注入輸送層は無機絶縁性ホール注入輸送層であって、この無機絶縁性ホール注入輸送層は、シリコンおよび/またはゲルマニウムの酸化物を主成分とし、主成分の平均組成を、(Si...Ge.) O、と表したとき

#### $0 \le x \le 1$

1.  $7 \le y \le 1$ . 99

である上記(1)~(4)のいずれかの有機EL素子。 (13) 前記無機絶縁性ホール注入輸送層の膜厚は、 0.1~3nmである上記(12)の有機EL素子。 【0013】

【発明の実施の形態】本発明の有機EL素子は、ホール 注入電極と電子注入電極と、これらの電極間に少なくと も発光層を有する有機層とを有し、前記発光層と電子注 入電極との間には無機絶縁性電子注入輸送層を有し、こ の無機絶縁性電子輸送層と電子注入電極との間には有機 の電子注入層を有する。

【0014】電子注入電極材料は、低仕事関数の物質が好ましく、例えば、K、Li、Na、Mg、La、Ce、Ca、Sr、Ba、Al、Ag、In、Sn、Z20n、Zr等の金属元素単体、または安定性を向上させるためにそれらを含む2成分、3成分の合金系、あるいはこれらの酸化物等を用いることが好ましい。また、Li、Na、K、Rb、Csなどのアルカリ金属の酸化物、フッ化物でもよい。合金系としては、例えばAg・Mg(Ag:0.1~50at%)、Al·Li(Li:0.01~12at%)、In・Mg(Mg:50~80at%)、Al·Ca(Ca:0.01~20at%)等が挙げられる。電子注入電極層にはこれらの材料からなる薄膜、それらの2種類以上の多層薄膜が用いられる。30

【0015】電子注入電極薄膜の厚さは、電子注入を十分行える一定以上の厚さとすれば良く、0.1m以上、好ましくは0.5m以上、特に1m以上とすればよい。また、その上限値には特に制限はないが、通常膜厚は1~500m程度とすればよい。電子注入電極の上には、さらに補助電極(保護電極)を設けてもよい。

【0016】補助電極の厚さは、電子注入効率を確保し、水分や酸素あるいは有機溶媒の進入を防止するため、一定以上の厚さとすればよく、好ましくは50nm以上、さらには100nm以上、特に100~500nmの範40囲が好ましい。補助電極層が薄すぎると、その効果が得られず、また、補助電極層の段差被覆性が低くなってしまい、端子電極との接続が十分ではなくなる。一方、補助電極層が厚すぎると、補助電極層の応力が大きくなるため、ダークスポットの成長速度が速くなってしまう等といった弊害が生じてくる。

【0017】補助電極は、組み合わせる電子注入電極の 材質により最適な材質を選択して用いればよい。例えば、電子注入効率を確保することを重視するのであれば Al等の低抵抗の金属を用いればよく、封止性を重視す る場合には、TiN等の金属化合物を用いてもよい。 【0018】電子注入電極と補助電極とを併せた全体の 厚さとしては、特に制限はないが、通常 $50\sim500$ nm 程度とすればよい。

6

【0019】ホール注入電極材料は、ホール注入層等へホールを効率よく注入することのできるものが好ましく、仕事関数 $4.5eV \sim 5.5eV$ の物質が好ましい。具体的には、錫ドープ酸化インジウム(ITO)、亜鉛ドープ酸化インジウム(IZO)、酸化インジウム( $In_O$ )、酸化スズ(SnO))および酸化亜鉛(ZnO)のいずれかを主組成としたものが好ましい。これらの酸化物はその化学量論組成から多少偏倚していてもよい。 $In_O$ ,に対するSnO,の混合比は、 $1\sim 20$  vt%、さらには $5\sim 12$  vt%が好ましい。また、IZO での $In_O$ ,に対するZnOの混合比は、通常、 $12\sim 32$  vt%程度である。

【0020】ホール注入電極は、仕事関数を調整するため、酸化シリコン (SiO,) を含有していてもよい。酸化シリコン (SiO,) の含有量は、ITOに対するSiO,のmol比で0.5~10%程度が好ましい。SiO,を含有することにより、ITOの仕事関数が増大する。

【0021】光を取り出す側の電極は、発光波長帯域、通常400~700m、特に各発光光に対する光透過率が50%以上、さらには80%以上、特に90%以上であることが好ましい。透過率が低くなりすぎると、発光層からの発光自体が減衰され、発光素子として必要な輝度を得難くなってくる。

【0022】電極の厚さは、50~500m、特に50 30~300mの範囲が好ましい。また、その上限は特に制限はないが、あまり厚いと透過率の低下や剥離などの心配が生じる。厚さが薄すぎると、十分な効果が得られず、製造時の膜強度等の点でも問題がある。

【0023】本発明の有機EL素子は、上記発光層と、電子注入電極(陰電極)との間に、有機層を介して無機 絶縁性電子輸送層を有する。

【0024】このように、無機材料からなる無機絶縁性電子輸送層を設けることで、無機材料の有するメリットと、有機材料の有するメリットとを併せもった有機EL素子とすることができる。すなわち、電極や発光層と、電子注入輸送層との界面での物性が安定し、製造が容易になる。また、従来の有機電子注入層を有する素子と同等かそれ以上の輝度が得られ、しかも、耐熱性、耐候性が高いので従来のものよりも寿命が長く、リークやダークスポットの発生も少ない。また、比較的高価な「機物質ではなく、安価で入手しやすい無機材料を用いているので、製造が容易となり、製造コストを低減することができる。

[0025] 無機絶縁性電子輸送層は、陰電極から出 子の注入を容易にする機能、電子を安定に輸送する機能 およびホールを妨げる機能を有するものである。この層は、発光層に注入されるホールや電子を増大・閉じこめさせ、再結合領域を最適化させ、発光効率を改善する。 【0026】すなわち、無機絶縁性電子輸送層を、上記主成分等により構成することにより、特別に電子注入機能を有する電極を形成する必要がなく、比較的安定性が高く、導電率の良好な金属電極を用いることができる。そして、無機絶縁性電子注入輸送層の電子注入輸送効率が向上すると共に、素子の寿命が延びることになる。

[0027] 無機絶縁性電子輸送層は、主成分として酸 10 化リチウム (Li,O)、酸化ルビジウム (Rb,O)、 酸化カリウム (K,O)、酸化ナトリウム (Na,O)、 酸化セシウム (Cs,O)、酸化ストロンチウム (Sr O)、酸化マグネシウム (MgO)、および酸化カルシ ウム (CaO) の1種または2種以上を含有する。これ らは単独で用いてもよいし、2種以上を混合して用いて もよく、2種以上を用いる場合の混合比は任意である。 また、これらのなかでは酸化ストロンチウムが最も好ま しく、次いで酸化マグネシウム、酸化カルシウム、さら に酸化リチウム (Li,O) の順で好ましく、次いで酸 20 化ルビジウム (R b, O)、次いで酸化カリウム (K ,O)、および酸化ナトリウム (Na,O) が好ましい。 これらを混合して用いる場合には、これらのなかで酸化 ストロンチウムが40 mo1%以上、または酸化リチウム と酸化ルビジウムの総計が40 mol%以上、特に50 m ol%以上含有されていることが好ましい。

【0028】無機絶縁性電子輸送層は、好ましくは安定 剤として酸化シリコン(SiO,)、および/または酸 化ゲルマニウム(GeO,)を含有する。これらはいず れか一方を用いてもよいし、両者を混合して用いてもよ く、その際の混合比は任意である。

[0029] 上記の各酸化物は、通常、化学量論的組成 (stoichiometric composition) となっているが、これから多少偏倚し、非化学量論的組成 (non-stoichiometry) となっていてもよい。

【0030】また、本発明の無機絶縁性電子輸送層は、 好ましくは上記各構成成分が全成分に対して、SrO、 MgO、CaO、Li,O、Rb,O、K,O、Na,O、 Cs,O、SiO、GeO,に換算して、

主成分:80~99 mol%、より好ましくは90~95 40 mol%、

安定剤: 1~20 mol%、より好ましくは 5~10 mol%、

#### 含有する。

【0031】無機絶縁性電子輸送層の膜厚としては、好ましくは0.1~2nm、より好ましくは0.3~0.8 nmである。電子注入層がこれより薄くても厚くても、電子注入層としての機能を十分に発揮できなくなくなってくる。

【003.2】無機絶縁性電子輸送層には、他に、不純物 50 るものではなく、形成方法によっても異なるが、通常5

として、Hやスパッタガスに用いるNe、Ar、Kr、 Xe等を合計5at%以下含有していてもよい。

【0033】なお、無機絶縁性電子輸送層全体の平均値 としてこのような組成であれば、均一でなくてもよく、 膜厚方向に濃度勾配を有する構造としてもよい。

【0034】無機絶縁性電子輸送層は、通常、非晶質状態である。

【0035】上記の無機絶縁性電子輸送層の製造方法としては、スパッタ法、蒸着法などの各種の物理的または化学的な薄膜形成方法などが考えられるが、スパッタ法が好ましい。なかでも、上記第1成分と第2成分のターゲットを別個にスパッタする多元スパッタが好ましい。多元スパッタにすることで、それぞれのターゲットに好適なスパッタ法を用いることができる。また、1元スパッタとする場合には、第1成分と第2成分の混合ターゲットを用いてもよい。

【0036】無機絶縁性電子輸送層をスパッタ法で形成する場合、スパッタ時のスパッタガスの圧力は、0.1~1Paの範囲が好ましい。スパッタガスは、通常のスパッタ装置に使用される不活性ガス、例えばAr、Ne、Xe、Kr等が使用できる。また、必要によりN、を用いてもよい。スパッタ時の雰囲気としては、上記スパッタガスに加えO、を1~99%程度混合して反応性スパッタを行ってもよい。

【0037】スパッタ法としてはRF電源を用いた高周波スパッタ法や、DCスパッタ法等が使用できる。スパッタ装置の電力としては、好ましくはRFスパッタで、 $0.1\sim10$  W/cm² の範囲が好ましく、成膜レートは $0.5\sim10$  nm/min 、特に $1\sim5$  nm/min の範囲が好ました。

【0038】成膜時の基板温度としては、室温(25℃)~150℃程度である。

【0039】また、本発明の有機EL素子は、有機層として上記発光層以外に無機の電子輸送層に加え有機の電子 子注入層を有する。

【0040】有機材料からなる電子注入層には、電子注入輸送性材料を用いることが好ましい。

【0041】具体的には電子注入層は、ドリス(8-キノリノラト)アルミニウム(A1q3)等の8-キノリノールまたはその誘導体を配位子とする有機金属錯体などのキノリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ベリレン誘導体、ピリジン誘導体、ピリミジン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ環機プルオレン誘導体等を用いることができる。

【0042】電子注入輸送層は発光層を兼ねたものでもよく、このような場合はトリス(8-キノリント)アルミニウム等を使用することが好ましい。電:日入層の形成は、発光層と同様に、蒸着等によればに [0043] 有機の電子注入層の厚さは、特に利望され

~500m程度、特に10~300mとすることが好ま しい。

【0044】発光層は、少なくとも発光機能に関与する 1種類、または2種類以上の有機化合物薄膜、またはそ の積層膜からなる。

【0045】発光層は、ホール(正孔)および電子の注 入機能、それらの輸送機能、ホールと電子の再結合によ り励起子を生成させる機能を有する。発光層には、比較 的電子的にニュートラルな化合物を用いることで、電子 とホールを容易かつバランスよく注入・輸送することが 10 できる。

【0046】発光層の厚さは、特に制限されるものでは なく、形成方法によっても異なるが、通常5~500mm 程度、特に10~300mとすることが好ましい。

【0047】有機EL素子の発光層には、発光機能を有 する化合物である蛍光性物質を含有させる。このような 蛍光性物質としては、例えば、特開昭63-26469 2号公報に開示されているような化合物、例えばキナク リドン、ルブレン、スチリル系色素等の化合物から選択 される少なくとも1種が挙げられる。また、トリス(8 20 ーキノリノラト) アルミニウム等の8-キノリノールま たはその誘導体を配位子とする金属錯体色素などのキノ リン誘導体、テトラフェニルブタジエン、アントラセ ン、ペリレン、コロネン、12-フタロペリノン誘導体 等が挙げられる。さらには、特開平8-12600号公 報 (特願平6-110569号) に記載のフェニルアン トラセン誘導体、特開平8-12969号公報(特願平 6-114456号) に記載のテトラアリールエテン誘 導体等を用いることができる。

【0048】また、それ自体で発光が可能なホスト物質 と組み合わせて使用することが好ましく、ドーパントと しての使用が好ましい。このような場合の発光層におけ る化合物の含有量は0.01~10体積%、さらには 0.1~5体積%であることが好ましい。また、ルブレ ン系では0.01~20体積%程度が好ましい。ホスト 物質と組み合わせて使用することによって、ホスト物質 の発光波長特性を変化させることができ、長波長に移行 した発光が可能になるとともに、素子の発光効率や安定 性が向上する。

【0049】ホスト物質としては、キノリノラト錯体が 40 好ましく、さらには8-キノリノールまたはその誘導体 を配位子とするアルミニウム錯体が好ましい。このよう なアルミニウム錯体としては、特開昭63-26469 2号、特開平3-255190号、特開平5-7073 3号、特開平5-258859号、特開平6-2158 74号等に開示されているものを挙げることができる。 【0050】具体的には、まず、トリス(8-キノリノ ラト) アルミニウム、ピス(8-キノリノラト)マグネ シウム、ピス (ベンソ (f) -8-キノリノラト) 亜・

ムオキシド、トリス (8-ギノリノラト) インジウム、 トリス (5-メチルー8-キノリノラト) アルミニウ ム、8-キノリノラトリチウム、トリス(5-クロロー 8-キノリノラト) ガリウム、ピス(5-クロロー8-キノリノラト) カルシウム、5、7-ジクロル-8-キ ノリノラトアルミニウム、トリス(5、7ージプロモー 8-ヒドロキシキノリノラト) アルミニウム、ポリ〔亜 鉛 (II) -ビス (8-ヒドロキシー5-キノリニル) メ タン] 等がある。

【0051】また、8-キノリノールまたはその誘導体 のほかに他の配位子を有するアルミニウム錯体であって もよく、このようなものとしては、ピス(2-メチルー 8-キノリノラト) (フェノラト) アルミニウム(III) 、ピス(2-メチル-8-キノリノラト)(オルト-クレゾラト) アルミニウム(111) 、ピス(2-メチルー 8-キノリノラト) (メタークレゾラト) アルミニウム (111) 、ピス (2-メチル-8-キノリノラト) (パラ ークレゾラト) アルミニウム(III) 、ビス (2 - メチル -8-キノリノラト) (オルトーフェニルフェノラト) アルミニウム(III) 、ピス (2-メチルー8-キノリノ ラト) (メターフェニルフェノラト) アルミニウム(II. 1)、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラト)(パラー フェニルフェノラト) アルミニウム(III) 、ビス(2-メチルー8-キノリノラト)(2,3-ジメチルフェノ ラト) アルミニウム(III) 、ピス (2-メチルー8-キ ノリノラト)(2、6ージメチルフェノラト)アルミニ ウム(III) 、ピス (2-メチル-8-キノリノラト) (3, 4-ジメチルフェノラト) アルミニウム(III) ピス(2-メチルー8-キノリノラト)(3.5-ジメ チルフェノラト) アルミニウム(III) 、ビス(2-メチ ルー8-キノリノラト) (3, 5-ジーtertープチルフ ェノラト) アルミニウム(III) 、ピス (2-メチル-8 ーキノリノラト) (2, 6ージフェニルフェノラト) ア ルミニウム(III) 、ビス(2 - メチル-8 - キノリノラ ト) (2, 4, 6-トリフェニルフェノラト) アルミニ ウム(III) 、ビス(2-メチル-8-キノリノラト) (2, 3, 6-トリメチルフェノラト) アルミニウム(1 II)、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(2, 3, 5, 6-テトラメチルフェノラト) アルミニウム(1 II)、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) (1-ナ フトラト) アルミニウム(III) 、ピス (2-メチル-8-ーキノリノラト) (2-ナフトラト) アルミニウム(II 1)、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラト)。 (オルトーフェニルフェノラト) アルミニウム(III).、 ピス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラト) (パラー フェニルフェノラト) アルミニウム(III) 、ビス(2... 4-ジメチル-8-キノリノラト) (メターフェニルフ ェノラト) アルミニウム(III) 、ピス(2, 4-ジメチ ルー8ーキノリノラト) (3, 5ージメチルフェノラ 鉛、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)。アルミニウ※50 ペト)アルミニウム(日日)。、ビス(2、4-ジメチルー8

ーキノリノラト) (3.5-ジーtert-ブチルフェノラト) アルミニウム( $\overline{\Pi}$ )、 ピス (2-メチル-4-エチル-8-キノリノラト) (パラークレゾラト) アルミニウム( $\overline{\Pi}$ )、 ピス (2-𝒴) (パラークレゾラト) アルミニウム( $\overline{\Pi}$ )、 ピス (2-𝒴) (パラーフェニルフェノラト) アルミニウム( $\overline{\Pi}$ )、 ピス (2-𝒴) (2-𝒴) (2-𝒴) アルミニウム( $\overline{\Pi}$ )、 ピス (2-𝒴) (2-𝒴) アルミニウム( $\overline{\Pi}$ ) 等がある。

【0052】このほか、ピス(2-メチルー8-キノリ ノラト)アルミニウム(III) -μ-オキソーピス(2-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(III) 、ビス (2,4-ジメチル-8-キノリノラト)アルミニウム (III)  $-\mu - \pi + y - Ux$  (2, 4 - y + y - 8 - 4ノリノラト) アルミニウム(III) 、ピス(4 - エチルー 2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウム(III) μーオキソービス (4-エチルー2-メチルー8-キノ リノラト) アルミニウム(111) 、ピス(2-メチル-4 ーメトキシキノリノラト) アルミニウム(III) ーμーオ 20 キソービス(2-メチル-4-メトキシキノリノラト) アルミニウム(III) 、ビス (5-シアノー2-メチルー 8-キノリノラト) アルミニウム(III) - μ-オキソー ピス(5 –シアノー 2 –メチルー 8 –キノリノラト)ア ルミニウム(III) 、ピス (2-メチルー5-トリフルオ ロメチル-8-キノリノラト) アルミニウム(III) -μ ーオキソーピス (2-メチル-5-トリフルオロメチル -8-キノリノラト) アルミニウム(III) 等であっても LVI

【0053】このほかのホスト物質としては、特開平8-12600号公報(特願平6-110569号)に記載のフェニルアントラセン誘導体や特開平8-12969号公報(特願平6-114456号)に記載のテトラアリールエテン誘導体なども好ましい。

【0054】発光層は電子注入輸送層を兼ねたものであってもよく、このような場合はトリス(8-キノリノラト)アルミニウム等を使用することが好ましい。これらの蛍光性物質を蒸着すればよい。

【0055】また、発光層は、必要に応じて、少なくとも1種のホール注入輸送性化合物と少なくとも1種の電 40子注入輸送性化合物との混合層とすることも好ましく、さらにはこの混合層中にドーパントを含有させることが好ましい。このような混合層における化合物の含有量は、0.01~20体積%、さらには0.1~15体積%とすることが好ましい。

【0056】混合層では、キャリアのホッピング伝導パスができるため、各キャリアは極性的に有利な物質中を移動し、逆の極性のキャリア注入は起こりにくくなるため、有機化合物がダメージを受けにくくなり、素子寿命がのびるという利点がある。また、前述のドーパントを50

このような混合層に含有させることにより、混合層自体 のもつ発光波長特性を変化させることができ、発光波長 を長波長に移行させることができるとともに、発光強度 を高め、素子の安定性を向上させることもできる。

~ 12 °

【0057】混合層に用いられるホール注入輸送性化合物および電子注入輸送性化合物は、各々、後述のホール注入輸送性の化合物および電子注入輸送性の化合物の中から選択すればよい。

【0058】電子注入輸送性の化合物としては、キノリン誘導体、さらには8-キノリノールないしその誘導体を配位子とする金属錯体、特にトリス(8-キノリノラト)アルミニウム(Alq3)を用いることが好ましい。また、上記のフェニルアントラセン誘導体、テトラアリールエテン誘導体を用いるのも好ましい。

【0059】ホール注入輸送性の化合物としては、強い 蛍光を持ったアミン誘導体、例えば上記のホール輸送材料であるトリフェニルジアミン誘導体、さらにはスチリルアミン誘導体、芳香族縮合環を持つアミン誘導体を用いるのが好ましい。

 【0060】この場合の混合比は、それぞれのキャリア 移動度とキャリア濃度によるが、一般的には、ホール注 入輸送性化合物の化合物/電子注入輸送機能を有する化 合物の重量比が、1/99~99/1、さらに好ましく は10/90~90/10、特に好ましくは20/80 ~80/20程度となるようにすることが好ましい。

【0061】また、混合層の厚さは、分子層一層に相当する厚み以上で、有機化合物層の膜厚未満とすることが好ましい。具体的には $1\sim85$ mとすることが好ましく、さらには $5\sim60$ m、特には $5\sim50$ mとすることが好ましい。

【0062】また、混合層の形成方法としては、異なる蒸着源より蒸発させる共蒸着が好ましいが、蒸気圧(蒸発温度)が同程度あるいは非常に近い場合には、予め同じ蒸着ボード内で混合させておき、蒸着することもできる。混合層は化合物同士が均一に混合している方が好ましいが、場合によっては、化合物が島状に存在するものであってもよい。発光層は、一般的には、有機蛍光物質を蒸着するか、あるいは、樹脂パインダー中に分散させてコーティングすることにより、発光層を所定の厚さに形成する。

【0063】真空蒸着の条件は特に限定されないが、10 'Pa以下の真空度とし、蒸着速度は0.01~1mm/sec 程度とすることが好ましい。また、真空中で連続して各層を形成することが好ましい。真空中で連続して形成すれば、各層の界面に不純物が吸着することを防げるため、高特性が得られる。また、素子の駆動電圧を低くしたり、ダークスポットの発生・成長を抑制したりすることができる。

【0064】これら各層の形成に真空蒸着法を用いる場合において、1層に複数の化合物を含有させる場合、化

合物を入れた各ポートを個別に温度制御して共蒸着する ことが好ましい。

【0065】本発明の有機EL素子は、発光層とホール 注入電極との間にホール注入輸送層として、有機のホー ル注入輸送層を油していてもよい。

【0066】有機のホール注入輸送層には、例えば、特 開昭63-295695号公報、特開平2-19169 4号公報、特開平3-792号公報、特開平5-234 681号公報、特開平5-239455号公報、特開平 5-299174号公報、特開平7-126225号公 10 報、特開平7-126226号公報、特開平8-100 172号公報、EP0650955A1等に記載されて いる各種有機化合物を用いることができる。例えば、テ トラアリールベンジシン化合物(トリアリールジアミン ないしトリフェニルジアミン: TPD)、芳香族三級ア ミン、ヒドラゾン誘導体、カルバゾール誘導体、トリア ソール誘導体、イミダソール誘導体、アミノ基を有する オキサジアソール誘導体、ポリチオフェン等である。こ れらの化合物は、1種のみを用いても、2種以上を併用 してもよい。2種以上を併用するときは、別層にして積 20 層したり、混合したりすればよい。

【0067】発光層、有機のホール注入輸送層、電子注 入層の形成には、均質な薄膜が形成できることから、真 空蒸着法を用いることが好ましい。真空蒸着法を用いた 場合、アモルファス状態または結晶粒径が 0.2 μm 以 下の均質な薄膜が得られる。結晶粒径が 0. 2 μm を超 えていると、不均一な発光となり、素子の駆動電圧を高 くしなければならなくなり、電子、ホールの注入効率も 著しく低下する。

[0068] 真空蒸着の条件は特に限定されないが、1~30 いて 0 'Pa以下の真空度とし、蒸着速度は0.01~1mm/ sec 程度とすることが好ましい。また、真空中で連続し て各層を形成することが好ましい。真空中で連続して形 成すれば、各層の界面に不純物が吸着することを防げる ため、高特性が得られる。また、素子の駆動電圧を低く したり、ダークスポットの発生・成長を抑制したりする ことができる。

【0069】これら各層の形成に真空蒸着法を用いる場 合において、1層に複数の化合物を含有させる場合、化 合物を入れた各ポートを個別に温度制御して共蒸着する 40 ことが好ましい。

【0070】本発明の有機EL素子は、上記発光層と、 ホール注入電極との間に、ホール注入輸送層として高抵 抗の無機ホール注入輸送層を有してもよい。

【0071】このように、ホールの導通パスを有し、電 子をプロックできる高抵抗の無機ホール注入輸送層を発 光層とホール注入電極との間に配置することで、発光層 ヘホールを効率よく注入することができ、発光効率が向 上するとともに駆動電圧が低下する。

輸送層の主成分としてシリコンや、ゲルマニウム等の金 属または半金属の酸化物を用い、これに仕事関数4.5 eV以上、好ましくは4.5~6eVの金属や、半金属およ び/またはこれらの酸化物、炭化物、窒化物、ケイ化 物、硼化物のいずれか1種以上を含有させて導電パスを 形成することにより、ホール注入層から発光層側の有機 層へ効率よくホールを注入することができる。しかも、 発光層からホール注入電極側への電子の移動を抑制する ことができ、発光層でのホールと電子との再結合を効率 よく行わせることができる。また、無機材料の有するメ リットと、有機材料の有するメリットとを併せもった有 機EL素子とすることができる。本発明の有機EL素子 は、従来の有機ホール輸送層を有する素子と同等かそれ 以上の輝度が得られ、しかも、耐熱性、耐候性が高いの で従来のものよりも寿命が長く、リークやダークスポッ トの発生も少ない。また、比較的高価な有機物質ばかり ではなく、安価で入手しやすく製造が容易な無機材料も 用いることで、製造コストを低減することもできる。

【0073】高抵抗の無機ホール注入輸送層は、その抵 抗率が好ましくは1~1×10''Ω・cm、特に1×10· '~1×10'Ω·cmである。高抵抗の無機ホール注入輸 送層の抵抗率を上記範囲とすることにより、高い電子ブ ロック性を維持したままホール注入効率を飛躍的に向上 させることができる。高抵抗の無機ホール注入輸送層の 抵抗率は、シート抵抗と膜厚からも求めることができ る。この場合、シート抵抗は4端子法等により測定する

【0074】主成分の材料は、シリコン、ゲルマニウム の酸化物であり、好ましくは (Si., Ge.) O、にお

 $0 \le x \le 1$ .

1.  $7 \le y \le 2$ . 2、好ましくは1.  $7 \le y \le 1$ : 99 である。高抵抗の無機ホール注入輸送層の主成分は、酸 化ケイ素でも酸化ゲルマニウムでもよく、それらの混合 薄膜でもよい。 yがこれより大きくても小さくてもホー ル注入機能は低下してくる傾向がある。組成は、例えば、 ラザフォード後方散乱、化学分析等で調べればよい。

【0075】高抵抗の無機ホール注入輸送層は、さらに 主成分に加え、仕事関数4.5eV以上の金属(半金属を 含む)の酸化物、炭化物、窒化物、ケイ化物および硼化 物を含有することが好ましい。仕事関数4.5eV以上、 好ましくは4.5~6eVの金属は、好ましくはAu.C u, Fe, Ni, Ru, Sn, Cr, Ir, Nb. P. t, W, Mo, Ta, PdおよびCoのいずれか1種ま た2種以上である。これらは一般に金属としてあるいは 酸化物の形で存在する。また、これらの炭化物、窒化 物、ケイ化物、硼化物であってもよい。これらを混合し て用いる場合の混合比は任意である。これらの含有量は 好ましくは0. 2~40 mol%、より好ましくは1~2 【007.2】また、好ましくは高抵抗の無機ホール注入 50 0 mol%である。含有量がこれより少ないとホール注入

機能が低下し、含有量がこれを超えると電子ブロック機能が低下してくる。2種以上を併用する場合、合計の含有量は上記の範囲にすることが好ましい。

【0076】上記金属または金属(半金属を含む)の酸化物、炭化物、窒化物、ケイ化物および硼化物は、通常、高抵抗の無機ホール注入輸送層中に分散している。分散粒子の粒径としては、通常、1~5m程度である。この導体である分散粒子同士との間で高抵抗の主成分を介してホールを搬送するためのホッピングパスが形成されるものと考えられる。

【0077】高抵抗の無機ホール注入輸送層には、他に、不純物として、Hやスパッタガスに用いるNe、Ar、Kr、Xe等を合計5al%以下含有していてもよい。

【0078】なお、高抵抗の無機ホール注入輸送層全体の平均値としてこのような組成であれば、均一でなくてもよく、膜厚方向に濃度勾配を有する構造としてもよい。

【0079】高抵抗の無機ホール注入輸送層は、通常、 非晶質状態である。

【0080】高抵抗の無機ホール注入輸送層の膜厚としては、好ましくは0.2~100mm、より好ましくは0.2~10m程度が好ましい。0.2~30mm、特に0.2~10m程度が好ましい。高抵抗の無機ホール注入輸送層がこれより薄くても厚くても、ホール輸送層としての機能を十分に発揮できなくなくなってくる。

【0081】上記の高抵抗の無機ホール注入輸送層の製造方法としては、スパッタ法、蒸着法などの各種の物理的または化学的な薄膜形成方法などが考えられるが、スパッタ法が好ましい。なかでも、上記主成分と金属または金属酸化物等のターゲットを別個にスパッタする多元スパッタが好ましい。多元スパッタにすることで、それぞれのターゲットに好適なスパッタ法を用いることができる。また、1元スパッタとする場合には、主成分のターゲット上に上記金属または金属酸化物等の小片を配置し、両者の面積比を適当に調整することにより、組成を調整してもよい。

【0082】高抵抗の無機ホール注入輸送層をスパッタ 法で形成する場合、成膜条件等は上記無機絶縁性電子注 入輸送層の場合と同様である。

【0083】本発明の有機EL素子は、高抵抗の無機ホール注入輸送層を有することにより、耐熱性、耐候性が向上し、素子の長寿命化を図れる。また、比較的高価な有機物質ではなく、安価で入手しやすい無機材料を用いているので、製造が容易となり、製造コストを低減することができる。さらには、従来問題のあった無機材料である電極との接続性も良好になる。このため、リーク電流の発生やダークスポットの発生を抑えることができる。

【0084】本発明の有機EL素子は、上記発光層とホ 50

ール注入電極との間に、ホール注入輸送層として無機絶縁性ホール注入輸送層を有してもよい。この無機絶縁性ホール注入輸送層は、シリコンおよび/またはゲルマニウムの酸化物を主成分とする。

【0085】また、好ましくは、主成分の平均組成、より好ましくはラザフォード後方散乱により得られる主成分の平均組成を、( $Si_1$ ,  $Ge_1$ ) O, と表したとき  $0 \le x \le 1$ 

1.  $7 \le y \le 1$ . 99

10 である。

【0086】このように、無機絶縁性ホール注入輸送層 の主成分である酸化物を上記組成範囲とすることによ り、ホール注入電極から発光層側の有機層へ効率よくホ ールを注入することができる。しかも、有機層からホー ル注入電極への電子の移動を抑制することができ、発光 層でのホールと電子との再結合を効率よく行わせること ができる。また、ホール注入輸送を目的としているた め、逆バイアスをかけると発光しない。特に、時分割駆 動方式など、高い発光輝度が要求されるディスプレイに 効果的に応用でき、無機材料の有するメリットと、有機 材料の有するメリットとを併せもった有機EL素子とす ることができる。本発明の有機EL素子は、従来の有機 ホール注入輸送層を有する素子と同等の輝度が得られ、 しかも、耐熱性、耐候性が高いので従来のものよりも寿 命が長く、リークやダークスポットの発生も少ない。ま た、比較的高価な有機物質ではなく、安価で入手しやす い無機材料を用いているので、製造が容易となり、製造 コストを低減することができる。

【0087】酸素の含有量を表すyは、上記組成範囲となっていればよく、1.7以上であって1.99以下である。yがこれより大きくても、yがこれより小さくてもホール注入能が低下し、輝度が低下してくる。また、好ましくは、好ましくは1.85以上であって1.98以下である。

【0088】無機絶縁性ホール注入輸送層は、酸化ケイ素でも酸化ゲルマニウムでもよく、それらの混合薄膜でもよい。これらの組成比を表すxは、0≦x≦1である。また、好ましくはxは0.4以下、より好ましくは0.3以下、特に0.2以下であることが好ましい。

【0089】あるいは、xは好ましくは0.6以上、より好ましくは0.7以上、特に0.8以上であってもよ

【0090】上記酸素の含有量は、ラザフォード後方散乱により得られた膜中の平均組成であるが、これに限心されるものではなく、これと同等な精度が得られる分析方法であればいずれの手法を用いてもよい。

【0091】無機絶縁性ホール注入輸送層には、他に不純物として、スパッタガスに用いるNe、Ar、バイ・Xe等を好ましくは合計10at%以下、より好まとくは0.01~2wt%、特に0.05~1.5wtm程度

含有していてもよい。これらの元素は1種でも2種以上 を含有していてもよく、これらを2種以上用いる場合の 混合比は任意である。

[0092] これらの元素はスパッタガスとして使用され、無機絶縁性ホール注入輸送層成膜時に混入する。これらの元素の含有量が多くなるとトラップ効果が極端に低下し、所望の性能が得られない。

【0093】スパッタガスの含有量は、成膜時の圧力と、スパッタガスと酸素の流量比、成膜レート等により、特に成膜時の圧力で決められる。スパッタガスの含 10 有量を上記範囲とするためには、高真空側で成膜した方が好ましく、具体的には、1Pa以下、特に0.1~1Paの範囲が好ましい。

【0094】なお、無機絶縁性ホール注入輸送層全体の平均値としてこのような組成であれば、均一でなくてもよく、膜厚方向に濃度勾配を有する構造としてもよい。この場合は、有機層(発光層)界面側が酸素プアであることが好ましい。

【0095】無機絶縁性ホール注入輸送層は、通常、非 晶質状態である。

【0.096】無機絶縁性ホール注入輸送層の膜厚としては、特に制限はないが、好ましくは $0.05\sim10$  nm、より好ましくは $0.1\sim5$  nm、特に $1\sim5$  nm、あるいは $0.5\sim3$  nm程度である。ホール注入層がこれより薄くても厚くても、ホール注入を十分には行えなくなってくる。

【0097】上記の無機絶縁性ホール注入輸送層の製造 方法としては、スパッタ法、EB蒸着法などの各種の物 理的または化学的な薄膜形成方法などが可能であるが、 スパッタ法が好ましい。

【0098】本発明の有機EL素子は、無機のホール注入輸送層を設けることにより、耐熱性、耐候性が向上し、素子の長寿命化を図れる。また、比較的高価な有機物質ではなく、安価で入手しやすい無機材料を用いているので、製造が容易となり、製造コストを低減することができる。さらには、従来問題のあった無機材料である電極との接続性も良好になる。このため、リーク電流の発生やダークスポットの発生を抑えることができる。

【0099】さらに、素子の有機層や電極の劣化を防ぐために、素子上を封止板等により封止することが好ましい。封止板は、湿気の浸入を防ぐために、接着性樹脂層を用いて、封止板を接着し密封する。封止ガスは、Ar、He、N,等の不活性ガス等が好ましい。また、この封止ガスの水分含有量は、100ppm以下、より好ましくは10ppm以下、特には1ppm以下であることが好ましい。この水分含有量に下限値は特にないが、通常0、1ppm程度である。

【0100】封止板の材料としては、好ましくは平板状であって、ガラスや石英、樹脂等の透明ないし半透明材料が挙げられるが、特にガラスが好ましい。このような 50

ガラス材として、コストの面からアルカリガラスが好ましいが、この他、ソーダ石灰ガラス、鉛アルカリガラス、ホウケイ酸ガラス、アルミノケイ酸ガラス、シリカガラス等のガラス組成のものも好ましい。特に、ソーダガラスで、表面処理の無いガラス材が安価に使用でき、好ましい。封止板としては、ガラス板以外にも、金属板、プラスチック板等を用いることもできる。

【0101】封止板は、スペーサーを用いて高さを調整し、所望の高さに保持してもよい。スペーサーの材料としては、樹脂ピーズ、シリカピーズ、ガラスピーズ、ガラスファイバー等が挙げられ、特にガラスピーズ等が好ましい。スペーサーは、通常、粒径の揃った粒状物であるが、その形状は特に限定されるものではなく、スペーサーとしての機能に支障のないものであれば種々の形状であってもよい。その大きさとしては、円換算の直径が $1\sim20~\mu m$ 、より好ましくは $1\sim10~\mu m$ 、特に $2\sim8~\mu m$  が好ましい。このような直径のものは、粒長 $10~0~\mu m$  以下程度であることが好ましく、その下限は特に規制されるものではないが、通常直径と同程度以上である。

【0102】なお、封止板に凹部を形成した場合には、スペーサーは使用しても、使用しなくてもよい。使用する場合の好ましい大きさとしては、前記範囲でよいが、特に2~8μmの範囲が好ましい。

【0103】スペーサーは、予め封止用接着剤中に混入されていても、接着時に混入してもよい。封止用接着剤中におけるスペーサーの含有量は、好ましくは0.01~30wt%、より好ましくは0.1~5wt%である。

[0104]接着剤としては、安定した接着強度が保て、気密性が良好なものであれば特に限定されるものではないが、カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ機脂接着剤を用いることが好ましい。

【0105】本発明において、有機EL構造体を形成する基板としては、非晶質基板たとえばガラス、石英など、結晶基板たとえば、Si、GaAs、ZnSe、ZnSe、ZnS、GaP、InPなどがあげられ、またこれらの結晶基板に結晶質、非晶質あるいは金属のパッファ層を形成した基板も用いることができる。また金属基板としては、Mo、Al、Pt、Ir、Au、Pdなどを用いることができ、好ましくはガラス基板が用いられる。基板は、光取り出し側となる場合、上記電極と同様な光透過性を有することが好ましい。

【0106】さらに、本発明素子を、平面上に多数並べてもよい。平面上に並べられたそれぞれの素子のそと色を変えて、カラーのディスプレーにすることができる。

【0107】基板に色フィルター膜や蛍光性物質を含む色変換膜、あるいは誘電体反射膜を用いて発光色を トロールしてもよい。

【0108】色フィルター膜には、液晶ディスプレット で用いられているカラーフィルターを用いれば1 有機EL素子の発光する光に合わせてカラーフィルターの特性を調整し、取り出し効率・色純度を最適化すれば よい

【0 1 0 9】また、EL素子材料や蛍光変換層が光吸収するような短波長の外光をカットできるカラーフィルターを用いれば、素子の耐光性・表示のコントラストも向上する。

【0110】また、誘電体多層膜のような光学薄膜を用いてカラーフィルターの代わりにしても良い。

【0111】蛍光変換フィルター膜は、EL発光の光を 10 吸収し、蛍光変換膜中の蛍光体から光を放出させることで、発光色の色変換を行うものであるが、組成としては、バインダー、蛍光材料、光吸収材料の三つから形成される。

【0112】蛍光材料は、基本的には蛍光量子収率が高いものを用いれば良く、EL発光波長域に吸収が強いことが望ましい。実際には、レーザー色素などが適しており、ローダミン系化合物・ペリレン系化合物・シアニン系化合物・フタロシアニン系化合物・対フタロシアニン等も含む)ナフタロイミド系化合物・縮合環炭化水素 20 系化合物・縮合複素環系化合物・スチリル系化合物・クマリン系化合物等を用いればよい。

【0113】パインダーは、基本的に蛍光を消光しないような材料を選べば良く、フォトリソグラフィー・印刷等で微細なパターニングが出来るようなものが好ましい。また、基板上にホール注入電極と接する状態で形成される場合、ホール注入電極(ITO、IZO)の成膜時にダメージを受けないような材料が好ましい。

【0114】光吸収材料は、蛍光材料の光吸収が足りない場合に用いるが、必要のない場合は用いなくても良い。また、光吸収材料は、蛍光性材料の蛍光を消光しないような材料を選べば良い。

【0115】本発明の有機EL素子は、通常、直流駆動型、パルス駆動型のEL素子として用いられるが、交流駆動とすることもできる。印加電圧は、通常、2~30 V程度とされる。

【0116】本発明の有機EL素子は、例えば図1に示すように、基板1/ホール注入電極2/ホール注入輸送 層3/発光層4/無機絶縁性電子輸送層5/有機の電子 注入層6/電子注入電極7とが順次積層された構成とし 40 てもよい。また、上記の積層順を逆にした、いわゆる逆 積層構成としてもよい。これらは、たとえば、ディスプレーの仕様や作製プロセス等により、適宜選択し使用される。図1において、ホール注入電極2と電子注入電極7の間には、駆動電源Eが接続されている。

【0117】また、上記発明の素子は、膜厚方向に多段に重ねてもよい。このような素子構造により、発光色の色調調整や多色化を行うこともできる。

【0118】本発明の有機EL素子は、ディスプレイとしての応用の他、例えばメモり読み出し/書き込み等に、50

利用される光ピックアップ、光通信の伝送路中における 中継装置、フォトカプラ等、種々の光応用デバイスに用 いることができる。

[0119]

【実施例】<実施例1>ガラス基板としてコーニング社 製商品名7059基板を中性洗剤を用いてスクラブ洗浄 した。

【0120】この基板上にITO酸化物ターゲットを用いRFマグネトロンスパッタリング法により、基板温度 250℃で、膜厚200mmのITOホール注入電極層を 形成した。

【0121】ITO電極層等が形成された基板の表面を UV/O, 洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定 して、槽内を1×10 Pa以下まで減圧した。

【0122】次いで、蒸着法により、MTDATAを蒸 着速度0.1nm/secで10nmの厚さに蒸着してホール 注入層を形成し、TPDを蒸着速度0.1nm/secで2 0nmの厚さに蒸着してホール輸送層を形成した。

【0124】さらに、減圧を保ったまま、スパッタ装置に移し、原料として酸化ストロンチウム(SrO)、酸化リチウム(Li,O)、酸化シリコン(SiO,) を、全成分に対しそれぞれ、

SrO: 80 mol%

Li, O: 10 mol%

SiO, :10 mol%

となるように混合したターゲットを用い、無機電子注入輸送層を0.8nmの膜厚に成膜した。このときの成膜条件として、基板温度25℃、スパッタガスAr、成膜レート1nm/min、動作圧力0.5Pa、投入電力5W/cm<sup>1</sup>とした。このとき、初めにスパッタガスをAr:100%として100SCCM供給しながら無機電子注入輸送層を0.4nmの膜厚に成膜し、続けてAr/O,:1/1として100SCCM供給しながら無機電子注入輸送層を0.4nmの膜厚に成膜した。

【0125】さらに、減圧を保ったまま、蒸着装置に移し、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(Alq3)を、全体の蒸着速度0.2nm/secとして30nmの厚さに蒸着し、電子注入層とした。

【0126】次いで、減圧を保ったまま、AlLi(Li:7at%)を1nmの厚さに蒸着し、続けてAlを200nmの厚さに蒸着し、電子注入電極および補助電極とし、最後にガラス封止して有機EL素子を得た。

【0127】得られた有機EL素子を空気中で、10mA

/cm² の定電流密度で駆動したところ、初期輝度は95 0 cd/m'、駆動電圧6.9V であった。

[0128] <実施例2>実施例1において、無機絶縁 性電子輸送層の主成分、安定剤を、それぞれ、SrOか らMgO、CaO、またはこれらの混合酸化物に、Li ,OからK,O、Rb,O、K,O、Na,O、Cs,O、ま たはこれらの混合酸化物に、SiO,からGeO,、ま たはSiO,とGeO,の混合酸化物に代えたところほ ぼ同様な結果が得られた。また、陰電極構成材料を、A lからAg, In, Ti, Cu, Au, Mo, W, P 10 , であった。 t, Pd. Ni、またはこれらの合金としても同様であ

【0129】 <実施例3>実施例1において、ホール注 入輸送層を形成する際に、スパッタ装置にて、ターゲッ トにSiO、と、この上に所定の大きさのAuのペレッ トを配置して用い、高抵抗の無機ホール注入輸送層を2 nmの膜厚に成膜した。このときのスパッタガスはAr: 3 0 sccm、O: 5 sccmで、室温 (25℃) 下、成膜レ ート1nm/min 、動作圧力0.2~2Pa、投入電力50 0Wとした。成膜した高抵抗の無機ホール注入輸送層の 20 組成は、SiO,,にAuを4 mol%含有するものであ

【0130】その他は実施例1と同様にして有機EL素 子を得た。得られた有機EL素子を実施例1と同様にし て評価したところ、発光輝度が向上し、駆動電圧が低下 した他は実施例1とほぼ同様の結果が得られた。

【0131】<実施例4>実施例3において、高抵抗の 無機ホール注入輸送層を成膜する際、ターゲットにGe O, と、このターゲット上に所定の大きさのAuのペレ ットを配置し、髙抵抗の無機ホール注入輸送層を20nm の膜厚に成膜した。このときのスパッタガスはAr:3 0 sccm、O<sub>2</sub>:5 sccmで、室温 (25℃)下、成膜レー ト 1 nm/min、動作圧力 0. 2~2 Pa、投入電力 5 0 0。 Wとした。成膜した無機ホール注入輸送層の組成は、G eO,にAuを2 mol%含有するものであった。

【0132】その他は実施例3と同様にして有機EL素 子を得た。得られた有機EL素子を実施例1と同様にし て評価したところ、実施例3とほぼ同様の結果が得られ

【0133】<実施例5>実施例3、4において、高抵 40 抗の無機ホール注入輸送層を成膜する際にスパッタガス のO. 流量、および膜組成によりターゲットを変えてそ の主成分の組成をSiO, 、SiO, 、、 Ge

O.,,、Si, Ge, O.,,とした他は実施例1と同 様にして有機EL素子を作製し、発光輝度を評価したと ころほぼ同等の結果が得られた。

【0134】<実施例6>実施例3~5において、高抵 抗の無機ホール注入輸送層の金属を、AuからCu、F e, Ni, Ru, Sn, Cr, Ir, Nb, Pt, W. Mo、Ta,PdおよびCoのいずれか1種以上、また、50~【図1】本発明の有機EL素子の基本構成を示す概略断

はこれらの酸化物、炭化物、窒化物、ケイ化物、硼化物 に代えても同等の結果が得られた。

【0135】<実施例7>実施例1において、ホール注 入輸送層を成膜する際にスパッタ装置にて、ターゲット にSiO, を用い、無機絶縁性ホール注入輸送層を2nm の膜厚に成膜した。このときのスパッタガスはArに対 しO, を5%混入して用いた、基板温度25℃、成膜レ ート 1 nm/min 、動作圧力 0. 5 Pa、投入電力 5 W/cm とした。成膜したホール注入輸送層の組成は、SiO

【0136】その他は実施例1と同様にして有機EL素 子を得た。得られた有機EL素子を実施例1と同様にし て評価したところ、発光輝度が向上した他は実施例1と ほぼ同様の結果が得られた。 

【0137】<実施例8>実施例7において、無機絶縁 性ホール注入輸送層を成膜する際に、ターゲットの組成 をSiO,とし、スパッタガスのO,流量を変えてAr に対する混合比を5%とし、その組成をSiO,,とし た他は実施例1と同様にして有機EL素子を作製し、夕 ーゲットの組成をSiO,とし、スパッタガスのO,流 量を変えてArに対する混合比を30%とし、その組成 をSiO, sとした他は実施例1と同様にして有機EL 素子を作製し、ターゲットの組成をGeO,とし、スパ ッタガスのO, 流量を変えてArに対する混合比を30 %とし、その組成をGeO...とした他は実施例1と同 様にして有機EL素子を作製し、ターゲットの組成をS i。、Ge、、O、とし、スパッタガスのO、流量を変え TArに対する混合比を10%とし、その組成をSi 。、Ge。、O、、、とした他は実施例1と同様にして有機 EL素子を作製し、評価した。

【0138】その結果、いずれの有機EL素子も実施例 7とほぼ同様の結果が得られることが確認できた。

【0139】 <比較例>実施例1において、ITOホー ル注入電極を形成した後、蒸着法により、MTDATA を蒸着速度 0. 1 nm/secで 1 0 nmの厚さに蒸着してホ ール注入層を形成し、TPDを蒸着速度0.1nm/sec で20mmの厚さに蒸着してホール輸送層を形成した。ま た、発光層を形成した後、さらにトリス(8-キノリノ ラト) アルミニウム (Alq3) とを、蒸着速度0.2 nm/secとして40nmの厚さに蒸着し、有機の電子注入輸 送層を形成した。その他は実施例1と同様にして有機E し素子を作製し、実施例1と同様にして評価したとこ ろ、10mA/cm<sup>2</sup>の定電流密度で駆動した初期輝度は7 5 0 cd/m' であった。

[0140]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、有機材料 と無機材料の有するメリットを併せ持ち、高効率、長寿 命で低コストな有機EL素子を提供することができる。 【図面の簡単な説明】

24.

#### 面図である。

【図2】従来の有機EL素子の構成例を示した概略断面 図である。

【図3】従来の有機EL素子の他の構成例を示した概略 断面図である。

## 【符号の説明】

- 1 基板
- 2 ホール注入電極
- 3 ホール注入輸送層
- 4 発光層

5 高抵抗の無機電子輸送層

6 電子注入層

7 電子注入電極

11 基板

12 ホール注入電極

13 電子注入電極

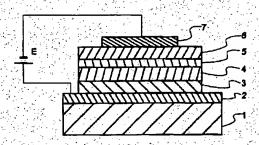
14 ホール輸送層

1.5 発光層

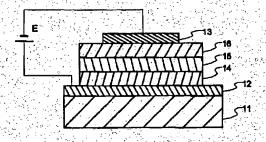
16 電子輸送層

10

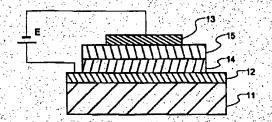
[図1]



[図3]



[図2]



# フロントページの続き

## (72)発明者 小堀 勇

東京都中央区日本橋一丁目13番1号。ティ ーディーケイ株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB00 AB03 AB05 AB06 AB18 BB01 BB04 BB06 CA00 CA01 CA02 CA04 CB01 DA00 DB03

EB00 FA01 FA02